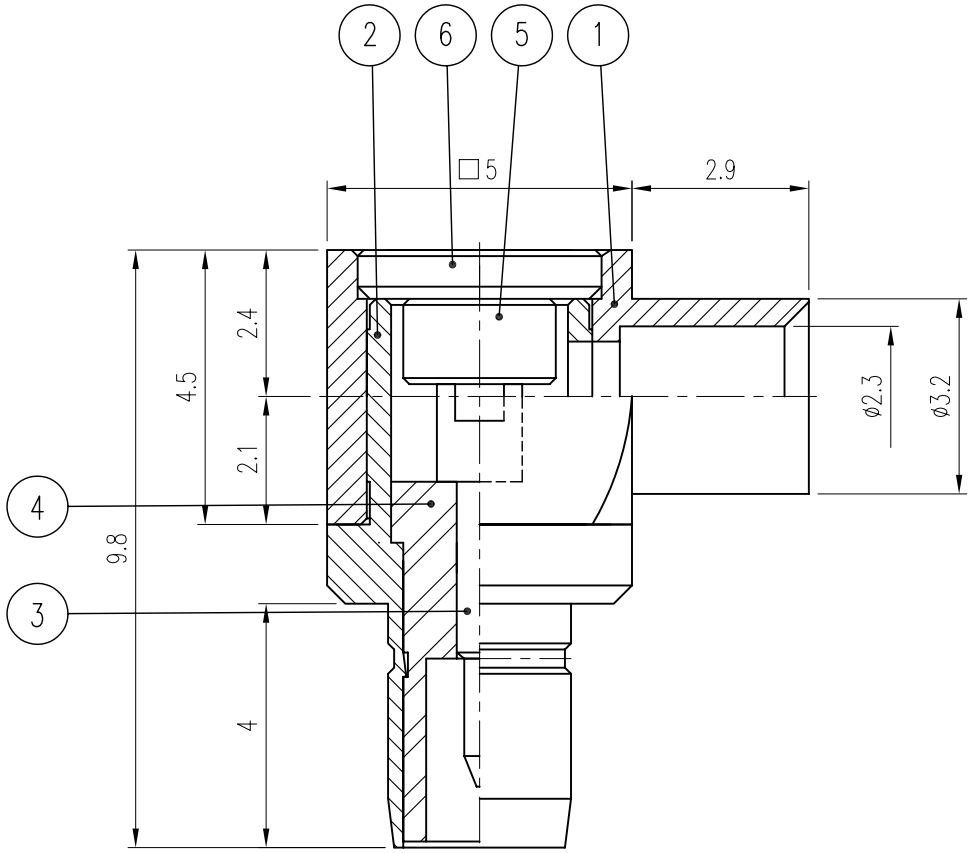
ST \ 가공									
ST(기존)									
ST(개선)									

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00014-5/1 (LS001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00939-N/1 (HT012)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00370-N/1 (HT011)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00430-5/1 (ET011)
2	BODY(B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00529-5/1 (DT012B)
1	BODY(A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00527-5/1 (DT012A)

대체가능재질

공통공차

소수 ± 0.1 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2004. 10. 25.

승인

검도

제도

직성부서 연 구 소

척도 8/1 단위 mm 중량 —

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMF-P-R/A UT-085

A4

도번 CN00919-7/1

K322-110-000